

2018-2023年中国集成电路产业市场运营规模现状 及未来发展前景预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国集成电路产业市场运营规模现状及未来发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/304169304169.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

集成电路是利用半导体工艺或厚膜、薄膜工艺，将晶体管、电阻、电容等电子元器件及布线互连一起，制作在同一介质基片上，然后封装在同一管壳内，成为具有特定功能的电路。相对于分立器件而言，集成电路因为具备体积小、功耗低、性能好、可靠性高及成本低的优点，在消费电子、网络通信、电子仪器、工业控制、军事等领域得到广泛应用。目前，集成电路产业是各国信息化发展的战略性产业，与经济发展和国防安全等息息相关，已成为衡量国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

目前，集成电路产业形成了两种发展模式：传统的 IDM 模式和垂直分工模式。在垂直分工模式下，集成电路行业由设计、晶圆代工（Foundry）、封装及测试组成产业分工，IC 设计公司则采用无生产加工线（Fabless）模式，只负责产品的开发和销售，生产环节委托 Foundry 和封装测试企业进行。

集成电路产业链资料来源：公开资料整理 近年来，我国集成电路制造业得到了快速发展，年产值已突破千亿元大关。受利好因素影响，国内正迎来新一轮集成电路投资热潮。

1、国内消费电子市场的火爆拉动内需，推动行业发展 近年来，随着国内集成电路内生增长动力的形成，尤其是以智能手机和平板电脑为代表的消费电子在国内的爆发式增长，推动了我国芯片行业的巨大发展。

2、全球半导体行业向中国转移，为 IC 设计提供良好的产业基础 集成电路行业作为信息技术的基础，在欧美、日本地区曾得到了极大的发展。垂直分工模式出现后，集成电路产业逐步向台湾、韩国转移。中国大陆凭借其巨大的消费电子市场、庞大的电子制造业基础以及劳动力成本优势，吸引了全球半导体厂商在国内投资。此外，政府对于集成电路产业的大力扶持，国内不断涌现出优质本土半导体企业，全球半导体产业中心开始向大陆转移。

观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书《2018-2023年中国集成电路产业市场运营规模现状及未来发展前景预测报告》主要研究集成电路行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。

第一章 集成电路基本情况

1.1 集成电路的相关介绍

1.1.1 集成电路定义

1.1.2 集成电路的分类

1.2 模拟集成电路

1.2.1 模拟集成电路的概念

1.2.2 模拟集成电路的特性

1.2.3 模拟集成电路较数字集成电路的特点

1.2.4 模拟集成电路的设计特点

1.2.5 模拟集成电路中不同功能的电路

1.3 数字集成电路

1.3.1 数字集成电路概念

1.3.2 数字集成电路的分类

1.3.3 数字集成电路的应用要点

第二章 2015-2017年世界集成电路的发展

2.1 2015-2017年国际集成电路的发展综述

2.1.1 产业发展历程

2.1.2 产业规模现状

2.1.3 产业发展特点

2.1.4 产业发展格局

2.1.5 产业经营模式

2.1.6 重要技术进展

2.1.7 产业发展策略

2.2 2015-2017年美国集成电路的发展

2.2.1 产业发展概况

2.2.2 行业发展经验

2.2.3 政策法规动态

2.2.4 企业营收分析

2.3 2015-2017年日本集成电路的发展

2.3.1 产业发展现状

2.3.2 产业分布状况

2.3.3 企业发展动向

2.3.4 IC技术应用

2.3.5 产业经验借鉴

2.4 2015-2017年中国台湾集成电路的发展

2.4.1 2015年产业状况

2.4.2 2016年产业现状

2.4.3 IC设计并购

2.4.4 产业发展经验

第三章 2015-2017年中国集成电路产业的发展

3.1 2015-2017年中国集成电路产业发展综述

3.1.1 产业发展历程

3.1.2 产业发展特点

3.1.3 产业发展规模

3.1.4 产业发展模式

3.1.5 产业基金发展

3.1.6 产品技术创新

3.1.7 产业应用创新

3.2 2015-2017年集成电路产业链的发展

3.2.1 产业链概况

3.2.2 产业链现状综述

3.2.3 产业链结构特点

3.2.4 产业链竞争分析

3.2.5 产业链重组现状

3.2.6 产业链商业模式

3.3 2015-2017年中国集成电路封测业发展状况

3.3.1 行业发展综述

3.3.2 企业销售排名

3.3.3 企业分布及产能

3.3.4 技术发展分析

3.3.5 行业竞争格局

3.4 中国集成电路制造业主要经济效益影响因素分析

3.4.1 相关产业

3.4.2 制度因素

3.4.3 产业环境

3.4.4 政府作用

3.5 中国集成电路产业发展问题分析

- 3.5.1 与国外的差距
- 3.5.2 投资规模不足
- 3.5.3 高端芯片依赖进口
- 3.5.4 产业链整合能力不足
- 3.5.5 跨国企业带来的问题
- 3.5.6 供给侧结构问题
- 3.6 中国集成电路行业发展对策分析
 - 3.6.1 加大整合力度
 - 3.6.2 产业链联动
 - 3.6.3 构建产学研用协同创新平台
 - 3.6.4 巨头引领企业发展
 - 3.6.5 产业可持续发展对策

第四章 2015-2017年集成电路产业热点及影响分析

- 4.1 工业化与信息化的融合对IC产业的影响
 - 4.1.1 有利于IC产业链建设
 - 4.1.2 为IC产业发展创造新局面
 - 4.1.3 为IC产业带来全新的应用市场
 - 4.1.4 促进IC产业与终端制造共同发展
- 4.2 两岸合作促进集成电路产业发展
 - 4.2.1 两岸合作正当时
 - 4.2.2 两岸合作须重视的问题
 - 4.2.3 两岸合作将成新常态
 - 4.2.4 福建合作发展
 - 4.2.5 厦门合作状况
- 4.3 支撑产业的发展对集成电路影响重大
 - 4.3.1 产业关键地位分析
 - 4.3.2 承接全球产能转移
 - 4.3.3 产业发展受制约
 - 4.3.4 产业链的重要性
 - 4.3.5 国际化发展策略
 - 4.3.6 绿色发展策略
- 4.4 集成电路产业知识产权分析
 - 4.4.1 产业面临知识产权保护问题
 - 4.4.2 产业知识产权状况分析

4.4.3 策略选择与运作模式

4.5 中国集成电路产业供给侧改革分析

4.5.1 供给侧改革必要性

4.5.2 产业供给不足原因

4.5.3 实施供给侧改革关注点

第五章 2015-2017年中国集成电路市场分析

5.1 中国集成电路市场整体情况

5.1.1 市场发展概况

5.1.2 市场需求状况

5.1.3 市场结构分析

5.1.4 区域市场格局

5.2 2015-2017年全国集成电路产量分析

5.2.1 2015-2017年全国产量趋势

5.2.2 2015年全国产量情况

5.2.3 2016年全国产量情况

5.2.4 2017年全国产量情况

5.2.5 2017年产量分布情况

5.3 2015-2017年中国集成电路市场竞争分析

5.3.1 市场竞争格局

5.3.2 园区发展竞争

5.3.3 企业全球化竞争

5.3.4 竞争力提升策略

第六章 2015-2017年集成电路设计业发展分析

6.1 中国集成电路设计业基本概述

6.1.1 IC设计产业链分析

6.1.2 IC设计所具有的特点

6.1.3 IC设计业的发展特点

6.1.4 SOC技术对行业的影响

6.2 2015-2017年中国IC设计行业发展分析

6.2.1 行业经营模式

6.2.2 行业发展现状

6.2.3 市场竞争状况

6.2.4 区域发展特点

6.2.5 企业经营状况

6.2.6 企业专利状况

6.3 中国IC设计业发展面临的问题

6.3.1 产品竞争力问题

6.3.2 企业总体实力不足

6.3.3 创新能力提升缓慢

6.3.4 产业发展存在掣肘

6.4 中国IC设计业的发展战略分析

6.4.1 优化产业发展环境

6.4.2 产业发展促进建议

6.4.3 重点产品开发建议

6.4.4 产业创新方向探析

6.5 中国IC设计业未来发展展望

6.5.1 产业未来前景展望

6.5.2 行业整合趋势明显

6.5.3 市场热点发展趋向

第七章 2015-2017年模拟集成电路发展分析

7.1 2015-2017年国际模拟集成电路产业概况

7.1.1 行业发展地位

7.1.2 市场需求分析

7.1.3 市场发展格局

7.2 2015-2017年中国模拟IC行业发展概况

7.2.1 模拟IC市场规模现状

7.2.2 模拟IC厂商面临机遇

7.2.3 高性能模拟IC需求旺盛

7.2.4 模数混合电路形势看好

7.3 中国模拟IC技术专利现状分析

7.3.1 专利数量增长趋势

7.3.2 专利技术分布状况

7.3.3 专利权利人排名

7.4 中国模拟IC行业发展的的问题及建议

7.4.1 重视技术研发

7.4.2 企业发展路径

7.4.3 产品整合方案

7.5 模拟IC市场的发展前景展望

7.5.1 全球市场规模预测

7.5.2 应用空间广阔

7.5.3 产品差异化趋势

第八章 2015-2017年中国集成电路重点区域发展分析

8.1 北京

8.1.1 产业支持政策

8.1.2 产业扶持基金

8.1.3 行业发展优势

8.1.4 产量规模现状

8.1.5 亦庄发展状况

8.1.6 中关村发展分析

8.2 上海

8.2.1 产业新政支持

8.2.2 行业销售收入

8.2.3 产量规模现状

8.2.4 产品出口规模

8.2.5 产业基金模式

8.2.6 产业项目启动

8.3 天津

8.3.1 相关扶持政策

8.3.2 产业优势介绍

8.3.3 行业发展状况

8.3.4 产量规模现状

8.4 深圳

8.4.1 产业发展优势

8.4.2 产业扶持政策

8.4.3 销售规模分析

8.4.4 进出口规模

8.4.5 产业园开园

8.5 山东

8.5.1 产业扶持政策

8.5.2 产业发展现状

8.5.3 产品进口规模

8.5.4 重大科技成就

8.5.5 产业发展规划

8.6 江苏

8.6.1 行业销售收入

8.6.2 产品产量规模

8.6.3 重点发展任务

8.6.4 行业保障措施

8.6.5 产业发展目标

8.7 其他地区

8.7.1 陕西省

8.7.2 湖南省

8.7.3 湖北省

8.7.4 合肥市

8.7.5 厦门市

8.7.6 成都市

第九章 2015-2017年中国集成电路进出口数据分析

9.1 2015-2017年中国集成电路进出口总量数据分析

9.1.1 2015-2017年中国集成电路进口分析

9.1.2 2015-2017年中国集成电路出口分析

9.1.3 2015-2017年中国集成电路贸易现状分析

9.1.4 2015-2017年中国集成电路贸易顺逆差分析

9.2 2015-2017年主要贸易国集成电路进出口情况分析

9.2.1 2015-2017年主要贸易国集成电路进口市场分析

9.2.2 2015-2017年主要贸易国集成电路出口市场分析

9.3 2015-2017年主要省市集成电路进出口情况分析

9.3.1 2015-2017年主要省市集成电路进口市场分析

9.3.2 2015-2017年主要省市集成电路出口市场分析

第十章 2015-2017年集成电路的相关元件产业发展

10.1 电容器

10.1.1 行业相关概述

10.1.2 行业政策环境

10.1.3 产业规模分析

10.1.4 行业进出口现状

- 10.1.5 技术水平现状
- 10.1.6 行业发展壁垒
- 10.1.7 行业影响因素
- 10.1.8 市场发展预测
- 10.2 电感器
 - 10.2.1 行业相关概述
 - 10.2.2 产业链结构
 - 10.2.3 市场规模分析
 - 10.2.4 市场需求状况
 - 10.2.5 行业竞争格局
 - 10.2.6 行业发展方向
- 10.3 电阻器
 - 10.3.1 行业相关概述
 - 10.3.2 市场需求状况
 - 10.3.3 行业进口现状
 - 10.3.4 市场发展方向
- 10.4 其它相关元件的发展概况
 - 10.4.1 晶体管
 - 10.4.2 光二极管（LED）产业

第十一章 2015-2017年集成电路应用市场发展分析

- 11.1 汽车工业分析及集成电路应用状况
 - 11.1.1 汽车工业产销状况分析
 - 11.1.2 汽车工业进出口状况分析
 - 11.1.3 汽车工业经济效益分析
 - 11.1.4 汽车行业集成电路应用状况
- 11.2 通信行业分析及集成电路应用状况
 - 11.2.1 通信业总体情况
 - 11.2.2 通信业用户发展情况
 - 11.2.3 通信业务使用情况
 - 11.2.4 通信业网络基础设施
 - 11.2.5 通信业经济效益
 - 11.2.6 通信业地区发展情况
 - 11.2.7 通信业固定资产投资
 - 11.2.8 通信业集成电路应用状况

11.3 消费电子市场分析及集成电路应用状况

11.3.1 消费电子市场发展状况

11.3.2 智能手机集成电路应用分析

11.3.3 电源管理IC市场分析

11.3.4 消费电子类集成电路技术分析

第十二章 2015-2017年国际集成电路知名企业分析

12.1 英特尔 (Intel)

12.1.1 企业发展概况

12.1.2 2015财年英特尔公司经营状况分析

12.1.3 2016财年英特尔公司经营状况分析

12.1.4 2017财年英特尔公司经营状况分析

12.2 亚德诺 (ADI)

12.2.1 企业发展概况

12.2.2 2015财年亚德诺经营状况分析

12.2.3 2016财年亚德诺经营状况分析

12.2.4 2017财年亚德诺经营状况分析

12.3 SK海力士 (SKhynix)

12.3.1 企业发展概况

12.3.2 2015年海力士经营状况分析

12.3.3 2016年海力士经营状况分析

12.3.4 2017年海力士经营状况分析

12.4 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)

12.4.1 企业发展概况

12.4.2 2015年恩智浦经营状况分析

12.4.3 2016年恩智浦经营状况分析

12.4.4 2017年恩智浦经营状况分析

12.5 德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS INC)

12.5.1 企业发展概况

12.5.2 2015年德州仪器经营状况分析

12.5.3 2016年德州仪器经营状况分析

12.5.4 2017年德州仪器经营状况分析

12.6 英飞凌 (Infineon Technologies AG)

12.6.1 企业发展概况

12.6.2 2015财年英飞凌经营状况分析

12.6.3 2016财年英飞凌经营状况分析

12.6.4 2017财年英飞凌经营状况分析

12.7 意法半导体集团 (STMicroelectronics)

12.7.1 企业发展概况

12.7.2 2015年意法半导体集团经营状况分析

12.7.3 2016年意法半导体集团经营状况分析

12.7.4 2017年意法半导体集团经营状况分析

第十三章 2015-2017年中国大陆集成电路重点上市公司分析

13.1 中芯国际集成电路制造有限公司

13.1.1 企业发展概况

13.1.2 2015年经营状况分析

13.1.3 2016年经营状况分析

13.1.4 2017年经营状况分析

13.2 杭州士兰微电子股份有限公司

13.2.1 企业发展概况

13.2.2 经营效益分析

13.2.3 业务经营分析

13.2.4 财务状况分析

13.2.5 未来前景展望

13.3 上海贝岭股份有限公司

13.3.1 企业发展概况

13.3.2 经营效益分析

13.3.3 业务经营分析

13.3.4 财务状况分析

13.3.5 未来前景展望

13.4 江苏长电科技股份有限公司

13.4.1 企业发展概况

13.4.2 经营效益分析

13.4.3 业务经营分析

13.4.4 财务状况分析

13.4.5 未来前景展望

13.5 吉林华微电子股份有限公司

13.5.1 企业发展概况

13.5.2 经营效益分析

- 13.5.3 业务经营分析
- 13.5.4 财务状况分析
- 13.5.5 未来前景展望
- 13.6 中电广通股份有限公司
 - 13.6.1 企业发展概况
 - 13.6.2 经营效益分析
 - 13.6.3 业务经营分析
 - 13.6.4 财务状况分析
 - 13.6.5 未来前景展望
- 13.7 上市公司财务比较分析
 - 13.7.1 盈利能力分析
 - 13.7.2 成长能力分析
 - 13.7.3 营运能力分析
 - 13.7.4 偿债能力分析

第十四章 中国集成电路行业投资分析

- 14.1 集成电路行业投资特性
 - 14.1.1 周期性
 - 14.1.2 区域性
 - 14.1.3 特有模式
 - 14.1.4 资金密集性
 - 14.1.5 其他特性
- 14.2 集成电路行业投资现状
 - 14.2.1 2015年投资规模
 - 14.2.2 2016年投资状况
- 14.3 集成电路行业投资壁垒
 - 14.3.1 技术壁垒
 - 14.3.2 人才壁垒
 - 14.3.3 资金壁垒
 - 14.3.4 其他因素
- 14.4 集成电路行业投资风险及策略
 - 14.4.1 投融资问题
 - 14.4.2 投资风险分析
 - 14.4.3 投资策略分析
 - 14.4.4 未来投资方向

14.4.5 区域投资建议

14.4.6 海外并购发展

14.4.7 引导理性投资

第十五章 集成电路行业发展规划及前景预测分析

15.1 国家集成电路产业发展推进纲要

15.1.1 现状与形势

15.1.2 总体要求

15.1.3 主要任务和发展重点

15.1.4 保障措施

15.2 中国集成电路行业技术趋势分析

15.2.1 技术动向解析

15.2.2 产业链技术趋势

15.2.3 硅集成技术趋势

15.3 “十三五”中国集成电路产业面临的机遇和挑战

15.3.1 面临的机遇

15.3.2 面临的挑战

15.4 2018-2022年中国集成电路行业预测分析

15.4.1 影响因素

15.4.2 收入预测

15.4.3 产量预测

图表详见正文（GYLPJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/304169304169.html>